

盛合晶微半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 A18 版)

注 2:2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/1-3 日总股本。

注 3:南矽电子 2024 年市盈率(扣非后)为负值和华天科技 2024 年市盈率(扣非后)为极值,均予以剔除。

本次发行价格 19.68 元/股,对应的发行人 2024 年市净率(每股净资产按照 2024 年度经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)为 2.00 倍,低于同行业可比公司 2024 年平均静态市净率 4.29 倍。本次发行价格对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 195.62 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司 2024 年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率 96.39 倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。相关情况详见 2026 年 4 月 8 日(T-1 日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 0.00001 美元。

(二) 发行数量和发行结构

本次公开发行股票数量为 25,546.6162 万股,占发行后公司总股本的比例为 13.71%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 186,277.4097 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 7,663.9848 万股,占本次发行数量的比例为 30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至中金公司指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 6,938.7770 万股,占发行总数的 27.16%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 725.2078 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 15,031.3392 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.78%;网上发行数量为 3,576.5000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.22%。最终网下、网上发行合计数量为 18,607.8392 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 19.68 元/股。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 480,000.00 万元。按本次发行价格 19.68 元/股和 25,546.6162 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额 502,757.41 万元,扣除发行费用约 24,897.30 万元(含增值税)后,预计募集资金净额约为 477,860.11 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五) 网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于 2026 年 4 月 9 日(T 日)15:00 同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于 2026 年 4 月 9 日(T 日)根据网上、网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,于 2026 年 4 月 7 日(T-2 日)首先回拨至网下发行。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 725.2078 万股回拨至网下发行。

2、2026 年 4 月 9 日(T 日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2026 年 4 月 10 日(T+1 日)在《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人与联席主承销商将于《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

战略配售股份限售期安排详见本公告“三、战略配售”。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2026年3月31日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交检查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和价格或价格区间(当日 13:00 后) 网下路演
T-5日 2026年4月1日 (周三)	网下投资者提交检查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和价格或价格区间 网下路演
T-4日 2026年4月2日 (周四)	网下投资者提交检查文件(当日中午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和价格或价格区间 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2026年4月3日 (周五)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和价格或价格区间(当日 9:30 前) 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2026年4月7日 (周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 确定参与战略配售的投资者最终获配数量 and 比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2026年4月8日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年4月9日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2026年4月10日 (周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2026年4月13日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2026年4月14日 (周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2026年4月15日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》 募集资金划至发行人账户

注 1:2026 年 4 月 9 日(T 日)为网上网下发行申购日;

注 2:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

注 3:如网上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《管理办法》、《实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”)、中微半导体(上海)有限公司(以下简称“中微半导体”)、上海天数智芯半导体股份有限公司(以下简称“天数智芯”)、北京摩笔生成科技有限公司(以下简称“摩笔生成”)、沐曦数智(上海)科技有限公司(以下简称“沐曦数智”)、北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)、聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰股份”)、上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微电”)、联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称“联芸科技”)、北京昂瑞微电子技术有限公司(以下简称“昂瑞微”)、唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“唯捷创芯”)、上海华虹宏力半导体制造有限公司(以下简称“华虹宏力”)、翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”)。

2、参与跟投的保荐人相关子公司:中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)。

3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛合一号资管计划”)。

截至本公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2026 年 4 月 8 日(T-1 日)公告的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。

(二) 参与战略配售的投资者的选取标准

中金财富系保荐人相关子公司,符合《实施细则》第四十一条第(四)项的规定,具备战略配售资格。

中金盛合一号资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划,已在中国证券投资基金业协会备案,符合《实施细则》第四十一条第(五)项的规定,具备战略配售资格。

海光信息、中微半导体、天数智芯、摩笔生成、沐曦数智、电控产投、聚辰股份、复旦微电、联芸科技、昂瑞微、唯捷创芯、华虹宏力、翱捷科技系与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,选择标准和考虑因素具体如下:

1、具备半导体设备领域技术领先优势,能够为先进封装提供关键设备支持并推动国产化适配,增强供应链自主可控能力;在半导体设备领域具备领先技术实力,能够为发行人先进封装工艺提供关键设备支持,通过新型设备开发、工艺协同适配等方式提升生产效率,推动设备与封装工艺的国产化适配,降低外部供应链依赖风险,增强供应链安全性和自主可控能力。

2、具备晶圆制造或芯片设计等关键环节深厚积累,具备较强品牌影响力,对先进封装服务有较强的需求;能够通过产品协同开发、客户导入及市场拓展等方式提升发行人产品在重点应用场景中的渗透率和市场占有率,预计能够持续带来订单增长和营收增量,促进规模效应释放;同时,具备长期持有意愿以及与发行人建立中长期稳定战略合作关系的基础和安排,通过优先采购、核心供应商认证、技术联合攻关等方式增强发行人长期价值创造能力。

(三) 获配结果

2026 年 4 月 7 日(T-2 日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 19.68 元/股,本次发行总规模为 502,757.41 万元。

依据《实施细则》,本次发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 5,109,323 股,获配金额 100,551,476.64 元。截至 2026 年 4 月 3 日(T-3 日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在 2026 年 4 月 15 日(T+4 日)之前,依据参与战略配售的投资者的缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	投资者类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	海光信息技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
2	中微半导体(上海)有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
3	上海天数智芯半导体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
4	北京摩笔生成科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
5	沐曦数智(上海)科技有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,081,300	1.99%	99,999,984.00	12
6	北京电控产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,319,105	1.69%	84,999,986.40	12
7	聚辰半导体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
9	联芸科技(杭州)股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,048,780	1.19%	59,999,990.40	12
10	北京昂瑞微电子技术有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12
11	唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12
12	上海华虹宏力半导体制造有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,540,650	0.99%	49,999,992.00	12
13	翱捷科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,778,455	0.70%	34,999,994.40	12
14	中金财富证券有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	5,109,323	2.00%	100,551,476.64	24
15	中金盛合芯途共赢一号员工参与战略配售集合资产管理计划	高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	16,006,097	6.27%	314,999,988.96	36
	合计		69,387,770	27.16%	1,365,551,313.60	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(四) 战略配售回拨

依据 2026 年 3 月 31 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 7,663.9848 万股,占本次发行数量的 30.00%,本次发行最终战略配售数量为 6,938.7770 万股,占发行总数的 27.16%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 725.2078 万股回拨至网下发行。

(五) 限售期安排

中金财富本次跟投获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 24 个月。

发行人的高级管理人员及核心员工持续看好发行人的发展前景,为全力支持公司发展,上述人员作为中金盛合一号资管计划的份额持有人,均承诺其获配份额限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 36 个月。

除上述战略配售投资者外,其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的投资者数量为 265 家,有效报价配售对象为 9,386 个,其对应的有效拟申购总量为 38,648,480 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2026 年 4 月 9 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 19.68 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配

(下转 A20 版)